

サンリッツエレクトロニクス 指定化学物質リスト

2024年 10月 3日 第5版

株式会社 サンリッツエレクトロニクス

目次

1. 用語の説明	2
2. 含有禁止物質	3
表-1 含有禁止物	3
3. 適用除外事項	7
表-2適用除外事項	7
4. 含有管理物質	10
表-3含有管理物質	10

1. 用語の説明

※含有

部品・材料・製品中に成分・内容物として化学物質が含まれていることをいいます。自然に含まれる化学物質(不純物)や、一般の工業的な精製段階において残ってしまうもの(不純物・残留溶剤・未反応モノマーなどの残留物)が含まれている場合も含有しているとします。

閾値レベルを超える場合、または意図的添加については含有とします。

工程中に付着、混入するものも含有とします。

※意図的添加

特定の特性、外観、または品質をもたらすために継続的な含有が望ましい場合に、製品または部品の形成時に故意に使用することです。

※閾値(しきいち)レベル

数値を判定する最大濃度レベルを指します。

含有禁止物質については、均質材料毎に 化学物質の質量／均質材料の質量 を算出。

含有管理物質については、部品材料毎に 化学物質の質量／部品材料の総質量 を算出。

※均質材料

機械的に別々に分離できない(ネジの取り外し、切断、粉砕、研磨などの機械的工程により分離できる)材料を意味します。

メッキ、塗料、樹脂、コーティング、金属、プラスチック、セラミック、紙、板など。

※IEC62474

International Electro technical Commission 62474 の略

国際電気標準会議(IEC)が定めた含有化学物質の開示手順の国際規格。

2012年3月に発行。報告対象物質は、JIG(電気・電子機器製品に関する含有化学物質情報

開示 ジョイント・インダストリー・ガイドライン)を引継ぎ IEC データベース 62474 で管理・公開されている。

2. 含有禁止物質

国内外の法規制により、製造や使用が禁止又は制限されている物質であり、IEC62474データベースの対象物質の一部を当社の含有禁止物質とする。

表-1 含有禁止物質

No.	化学物質群	含有禁止基準	主な法令等
1	アスベスト類	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	REACH 規則
2	一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料	人体の皮膚に直接、長時間接触する可能性がある皮革・繊維製品およびその部品に使用される場合のみ適用 ①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.003wt% (30ppm)を「超えてはならない	REACH 規則
3	カドミウム/カドミウム化合物	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が100ppmを超えてはならない ④電池の場合は5ppm以下 ⑤梱包材の場合、不純物の場合であっても、素材毎に4物質(注1)それぞれの含有率の合計が100ppmを超えてはならない。 除外用途:表-2	RoHS 指令 REACH 規則
4	六価クロム化合物	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.1wt% (1000ppm)を超えてはならない ④梱包材の場合、不純物の場合であっても、素材毎に4物質(注1)それぞれの含有率の合計が100ppmを超えてはならない。 除外用途:表-2	RoHS 指令
5	五酸化二ヒ素 (CAS No.1303-28-2)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.1wt% (1000ppm)を超えてはならない	REACH 規制
6	三酸化二ヒ素 (CAS No.1327-53-3)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.1wt% (1000ppm)を超えてはならない	REACH 規制
7	フッ素系温室効果ガス (PFC、SF6、HFC)	一液発泡体として製品及びその部品に使用される場合のみ適用 ①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	EU 規制

No.	化学物質群	含有禁止基準	主な法令等
8	ホルムアルデヒド	織物製品及びその部品に使用される場合のみに適用 ①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③織物製品の場合織物重量の0.0075wt%(75ppm)を超えてはならない	オーストリア法 リトアニア法
9	ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)およびすべての主要ジアステレオ異性体 CAS No.25637-99-4 CAS No.3194-55-6	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.1wt%(1000ppm)を超えてはならない	REACH 規制
10	鉛/鉛化合物	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.1wt%(1000ppm)を超えてはならない ④被膜電線の場合は表層被覆の0.03wt%(300ppm)を超えてはならない ⑤玩具の塗料および表面塗装においては表面塗装の0.009wt%(90ppm)を超えてはならない ⑥電池の場合は0.004wt%(40ppm)を超えてはならない ⑦梱包材の場合、不純物の場合であっても、素材毎に4物質(注1)それぞれの含有率の合計が100ppmを超えてはならない。 除外用途:表-2	RoHS 指令 REACH 規制 カリフォルニア州法「プロポジション 65」
11	水銀/水銀化合物	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が0.1wt%(1000ppm)を超えてはならない ④電池の場合は0.0001wt%(1ppm)を超えてはならない ⑤梱包材の場合、不純物の場合であっても、素材毎に4物質(注1)それぞれの含有率の合計が100ppmを超えてはならない。 除外用途:表-2	RoHS 指令 REACH 規制
12	ニッケル	①人体の皮膚に直接、長時間接触する可能性がある部位に使用する場合のみ意図的添加禁止	REACH 規制

No.	化学物質群	含有禁止基準	主な法令等
13	オゾン層破壊物質 (CFC 類、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、ハロン、HBFC 類、臭化メチル、ブromoklorometan、HCFC 類)	モントリオール議定書のオゾン層破壊物質 ①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	モントリオール議定書 EC No.2037/2000 EC No.1005/2009
14	過塩素酸塩	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.0000006wt% (0.006ppm) を超えてはならない	米国カリフォルニア州 DTSC 規則設定
15	パーフルオロオクタンスルフォン酸塩 (PFOS)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 除外用途: 表-2	REACH 規制
16	フェノール、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ビス(1,1-ジメチルエチル) (CAS No.3846-71-7)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	化審法
17	フタル酸エステル類 DEHP :(CAS No.117-81-7) DBP:(CAS No.84-74-2) BBP:(CAS No.85-68-7)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.1wt% (1000ppm) を超えてはならない	RoHS 指令
18	フタル酸エステル類 DINP :(CAS No.28553-12-0、 CAS No.68515-48-0) DIDP :(CAS No.26761-40-0、 CAS No.68515-49-1) DNOP :(CAS No.117-84-0)	①子供の口近くに位置される玩具、または子供介護用品のみ意図的添加禁止 ②子供の口近くに位置される玩具、または子供介護用品のみ製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③子供の口近くに位置される玩具、または子供介護用品のみ不純物であっても含有率が可塑化剤の 0.1wt% (1000ppm) を超えてはならない	REACH 規制
19	ポリ臭化ビフェニル類 (PBB 類)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.1wt% (1000ppm) を超えてはならない	RoHS 指令
20	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE 類)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.1wt% (1000ppm) を超えてはならない	RoHS 指令
21	ポリ塩化ビフェニル類 (PCB 類) および 特定代替品	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	REACH 規制 化審法
22	ポリ塩化ターフェニル類 (PCT 類)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	REACH 規制 化審法

No.	化学物質群	含有禁止基準	主な法令等
23	ポリ塩化ナフタレン類(塩素原子 3 個以上)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止	化審法
24	放射性物質	①意図的添加禁止	EU-D96/29Euratom
25	短鎖型塩化パラフィン類 (CASNo.85535-84-8)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.1wt% (1000ppm)を超えてはならない	REACH 規制
26	三置換有機スズ化合物 (TBTO を除く)	納入品の総重量におけるスズ含有率が 1000ppmを超えてはならない	化審法 REACH 規制
27	トリブチルスズ=オキシド (TBTO) (CAS No.56-35-9)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.1wt% (1000ppm)を超えてはならない	REACH 規則 化審法
28	フタル酸ジイソブチル DIBP :(CAS No.84-69-5)	①意図的添加禁止 ②製造工程中の付着・混入・生成禁止 ③不純物であっても含有率が 0.1wt% (1000ppm)を超えてはならない	RoHS 指令

【表-1に関する注】

(注1) 梱包材の場合の4物質

カドミウム／カドミウム化合物、六価クロム化合物、鉛／鉛化合物、及び水銀／水銀化合物

化学物質詳細は IEC62474”Material Declaration for Products of and for the Electro technical Industry”(電気・電子業界及びその製品に関するマテリアルデklarレーション)データベースを参照願います。 <http://std.iec.ch/iec62474>

3. 適用除外事項

禁止物質について、下記項目が除外となっています。

表-2 適用除外事項

対象物質	適用除外（注1）
カドミウム／カドミウム化合物	<p>8(b)－I 以下の用途に使用された電気接点中のカドミウムおよびその化合物</p> <ul style="list-style-type: none"> －サーキットブレーカー －熱感知制御装置 －サーマルモータプロテクタ(密閉型サーマルモータプロテクタを除く) －下記定格の AC スイッチ <ul style="list-style-type: none"> －AC250V6A 以上 －AC125V12A 以上 －定格 DC スイッチ DC18V20A 以上 －電圧供給周波数 200Hz 以上使用するスイッチ <p>(禁止期日に関しては、注 2 参照)</p> <p>13(b)－(II) 付属書の除外 39* に該当する用途を除く、ストライキング光学フィルタガラスタイプ中のカドミウム</p> <p>(禁止期日に関しては、注 2 参照)</p> <p>* 除外番号 39: イルミネーション又はディスプレイ・システム用途の色変換Ⅱ－Ⅵ族化合物半導体 LED(発行領域mm²あたりのカドミウム<10μg)に含まれるカドミウム。</p> <p>13(b)－(III) 反射標準物質用のグレースに含まれるカドミウム</p> <p>(禁止期日に関しては、注 2 参照)</p>

対象物質	適用除外（注1）
鉛／鉛化合物	<p>6(a)－Ⅰ 機械加工用の鋼材中に合金成分として含まれる 0.35wt%の鉛およびバッチ式の溶融亜鉛めっき鋼材部品中に含まれる 0.2wt%までの鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>6(b)－Ⅰ 鉛を含有するアルミニウムのスクラップをリサイクルして得られたアルミニウムに合金成分として含まれる 0.4wt%までの鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>6(b)－Ⅱ 機械加工用のアルミニウムに合金成分として含まれる 0.4wt%までの鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>6(c) 銅合金に含まれる 4wt%までの鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>7(a) 高融点はんだに含まれる鉛(鉛含有率が 85wt%以上の鉛ベースの合金) （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>7(c)－Ⅰ キャパシタ中の静電セラミックを除くガラス又はセラミック中の電気電子部品に含む鉛、例えばエピソードデバイス、ガラスあるいはセラミックマトリックス化合物 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>7(c)－Ⅱ AC125V あるいは DC250V 以上の電圧用のキャパシタ中の誘電セラミックに含まれる鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>13(a) 光学用のホワイト(無色、透明な)ガラス中の鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>13(b)－Ⅰ イオン着色された光学フィルタガラスタイプ中の鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>13(b)－Ⅲ 反射標準物質用のグレーズに含まれる鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>15(a) 以下の基準の少なくとも一つが当てはまる際の集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間における確実な電気接続に必要な はんだに含まれる鉛 <ul style="list-style-type: none"> - 90nm 以上の半導体テクノロジーノード - いかなる半導体テクノロジーノードにおいても単一ダイサイズが 300mm² 以上 - 300mm² 以上のダイまたは 300mm² 以上のシリコンのインターポーザ付きスタック型ダイパッケージ （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>34 サーマットベースのトリマー電位差計の構成要素中の鉛 （禁止期日に関しては、注 2 参照）</p> <p>37 ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイオードのメッキ層中の鉛 （2025 年 12 月 31 日から禁止）</p>

対象物質	適用除外（注1）
水銀／水銀化合物	3 特別目的の冷陰極線蛍光灯及び外部電極蛍光ランプ（CCFL及びEEFL）中の以下の値を超えない水銀（1ランプあたり） (a)短管（500mm以下）：3.5mg (b)中管（500mm超1500mm未満）：5mg (c)長管（1500mm超）：13mg （2025年2月24日から禁止）

【表－2に関する注】

（注1）表中の番号は RoHS 指令官報に記載されている適用除外の番号

（注2）欧州委員会に於ける除外更新検討中の為、最短でも更新内容の官報が交付されるまで有効とする。

4 含有管理物質

当社指定の含有禁止物質以外の IEC62474 データベースの対象物質に相当し
含有量の把握・管理を必要とする物質(表-3)で、含有管理基準により管理願います。

表-3 含有管理物質

No.	化学物質群	含有管理基準	主な法令等
1	リン酸トリス (2-クロロエチル) (TCEP)	製品の0.1wt% (1000ppm)	REACH 規制
2	酸化ベリリウム (BeO)	製品の 0.1wt% (1000ppm)	DEGITALEUROPE/CECED/AeA/EERA ガイダンス
3	臭素系難燃剤(PBB とPBDE 又は HBCDD 以外)	製品の 0.1wt% (1000ppm)	DEGITALEUROPE/CECED/AeA/EERA ガイダンス
4	ポリ塩化ビニル	製品の 0.1wt% (1000ppm)	IEEE1680(EPEAT: 電子製品環境アセスメントツール)
5	ジブチルスズ化合物 (DBT)	製品の 0.1wt% (1000ppm)	REACH 規制
6	ジオクチルスズ化合物 (DOT)	製品の 0.1wt% (1000ppm)	REACH 規制
7	その他の SVHC (当社禁止物質以外) 注1)	製品の 0.1wt% (1000ppm)	REACH 規制

【表-3に関する注】

注1) 欧州化学品庁(ECHA)によって認可対象物質の候補リスト(Candidate List)に掲載された SVHC(高懸念物質)は IEC62474 のデータベースに追加され次第、当社の「含有管理物質」としますので、製品の 0.1wt%を超える濃度で含有する場合は管理願います。

化学物質詳細は IEC62474 データベースを参照願います。

【改訂履歴】

2014年 6月 25日 第1版 初版制定(グリーン調達ガイドラインより移行)

2017年 4月 21日 第2版 禁止物質追加

2019年11月 20日 第3版 適用除外事項改定

2021年 9月 30日 第4版 適用除外有効期限変更

2024年10月 3日 第5版 適用除外事項改定

【問合せ先】

株式会社 サンリッツエレクトロニクス 購買部署

TEL 049-223-1153

FAX 049-223-3221

お問い合わせは、購買部署にお願いします。